



Ball-Wedge Bonder 5310

Bond System

Drahttypen	Golddrähte 17,5-50µm auf 2"-Spule
Bondkopf	Ball-Wedge für Golddrähte Standardkapillare 16mm Läng (optional 19mm)
Ultraschall System	F&S Generator 67kHz (optional 100, 120, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub • Schrittauflösung: 1 µm • Standard-Arbeitshöhe: 55 mm • Manipulator in X und Y: 18x18 mm • entspricht Untersetzung: 1:7
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, • Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In, • interne Festplatte, Bedienung und Menü-Führung über Shuttlerad mit Quittierungstaster
Software	<ul style="list-style-type: none"> • programmierbare Einzelbonds • Loopformen speicherbar
Steuerung	Manuell
Abmessung	B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
Anschlüsse	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

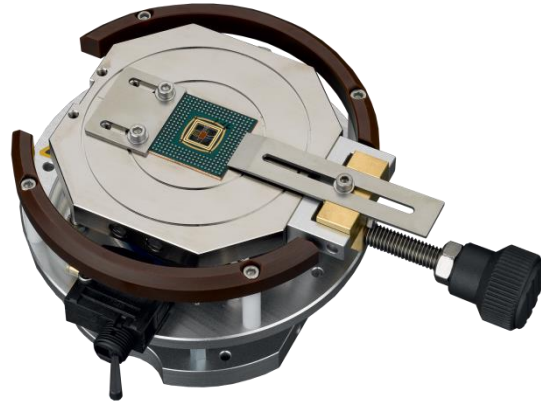
Der Gold-Ballbonder 5310 verarbeitet Golddrähte von 17,5 bis 50 µm, sowohl im Bumpingmodus als auch im Stitchbondmodus. Durch die motorgesteuerte Bewegung in der Z-Achse haben Sie stets reproduzierbare Bondergebnisse.

Zusätzlich können sämtliche Parameter auf der internen Festplatte gespeichert werden. Die Bedienführung über ein Farbdisplay und die Eingabe durch ein Wählrad machen die Programmierung und die Handhabung sehr einfach. Der Operator kann durch das Manipulatorsystem verschiedene Looparten erzeugen. Das erlaubt die Bedienung auch durch wenig geschultes Personal.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben, optimale Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
Mit mechanischer Klemmung
Ø80mm



Optional:



Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at



Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täfernstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

